

Applied Materials : vers un rebond des semi-conducteurs

Au coeur de l'équipement des fondeurs, les fabricants de semi-conducteurs, qui mieux qu'Applied Materials – premier équipementier mondial de l'industrie des semi-conducteurs – peut donner la température du secteur ?

Reprenant les propos de son patron Mike Splinter lors d'une conférence aux investisseurs, Houcken Tseng, vice-président de l'équipementier et représentant du groupe en Asie, a confirmé sa vision pour la fin de l'année.

Certes, le premier trimestre fiscal du groupe, clos le 28 janvier, accuse un léger repli, mais c'est probablement pour préparer un substantiel rebond avec l'adoption des équipements en 65 nanomètres et préparer l'arrivée des 45 nm.

Ainsi, selon la vision d'Applied Materials, si l'industrie devrait « *toucher le fond* » en avril, pour reprendre l'expression de Houcken Tseng, la demande devrait rebondir et accélérer au cours du second semestre.

L'équipementier souligne également la meilleure maîtrise de la pression des inventaires sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. L'industrie aurait en partie assimilé les aléas des fluctuations cycliques qui ont marqué les années antérieures, et les surstocks emmagasinés depuis la mi 2006 seraient bientôt écoulés.

Quoi qu'il en soit, Applied Materials souligne la multiplication chez les fondeurs des 'design' de semi-conducteurs en 65 nm sur wafer de 300 mm (plaque sur laquelle les processeurs sont sérigraphiés), et y voit un signe de déploiement en volume des équipements dans les prochains trimestres.

Derniers fondeurs à adopter la géométrie en 65 nm, Broadcom et Qualcomm, qui vont rejoindre Intel, IBM, AMD, Freescales, les japonais et quelques Taïwanais...